文章编号: 1001-3806(2017)02-0240-07

强激光下4H—SiC 晶体电子特性的第一性原理研究

邓发明1,高 涛2

(1. 四川民族学院 数学系,康定 626001;2. 四川大学 原子与分子物理研究所,成都 610065)

摘要:为了研究4H—SiC 晶体在强激光辐照下电子特性及其变化,采用基于密度泛函微扰理论的第一性原理赝势的方法,对纤锌矿4H—SiC 晶体在强激光照射下的电子特性的变化进行了理论分析和实验验证。结果表明,电子温度 *T*_e在0eV~2.75eV 范围内时,4H—SiC 仍然是间接带隙的半导体晶体;当电子温度 *T*_e升高达到并超过 3.0eV 以上时, 4H—SiC 变为直接带隙的半导体晶体;电子温度 *T*_e在0eV~2.0eV 变化时,带隙值随电子温度升高而增大;电子温度 *T*_e 在 2.0eV~3.5eV 变化时,带隙值随电子温度 *T*_e的升高而迅速地减小;当电子温度 *T*_e高于 3.5eV 以后,带隙已经消失而 呈现出金属特性。该研究对制作 4H—SiC 晶体特殊功能电子元件是有帮助的。

关键词: 激光技术;电子特性;密度泛函微扰理论;4H—SiC;激光照射

中图分类号: 0469 文献标志码: A doi:10.7510/jgjs. issn. 1001-3806. 2017. 02. 019

First principle study of electronic properties of 4H—SiC under high power laser

DENG Faming¹, GAO Tao²

(1. Department of Mathematics, Sichuan University for Nationalities, Kangding 626001, China; 2. Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: In order to investigate the electronic properties of 4H—SiC crystal under high power laser irradiation, the first principles with pseudo potential method based on density functional perturbation theory was applied to theoretically analyze and experimentally verify the electronic properties of wurtzite 4H—SiC erystal under the strong laser irradiation. The results indicate that 4H—SiC remains semiconductor with indirect band-gap in the range of $0eV \sim 2.75eV$. When the electronic temperature reaches above 3.0eV, the crystal turns to be semiconductor with direct band-gap. The forbidden bandwidth increases with the rising of T_e in the range of 0eV and 2.0eV, and the forbidden bandwidth quickly reduces with the rising of T_e in the range of 2.0eV ~ 3.5eV. When T_e is over 3.5eV, the gap has disappeared and metallic properties are presented. The study will be helpful for making special function electronic components of 4H—SiC crystal.

Key words: laser technique; electronic property; density functional perturbation theory; 4H-SiC; laser irradiation

引 言

用强激光辐射金刚石结构的半导体物质时,van VECHTEN 等人^[1]观察到晶体结构变得不稳定,分析 认为,当超强激光与半导体物质相互作用时,因电子吸 收而存储在半导体物质中的超强激光能量,会在几十 飞秒时间内,将半导体物质中的电子加热到热力学温 度为10⁴K的高温,并借助晶体内的电子与电子、电子 与空穴的超快碰撞,晶体在超快时间内升高到其对应 的电子温度,从而使晶体在超快时间内非热熔化。

E-mail:dfm@ scun. edu. cn

收稿日期:2016-04-12;收到修改稿日期:2016-09-13

近年来,学者们通过理论研究和大量的实验都已 证明,在高强度激光辐照下,非热熔化引起了晶体物质 的物理特性变化。科学家们用强激光辐照半导体材料 如硅、砷化镓、锑化铟、镓等晶体后发生的非热相变进 行了讨论^[2-5]。基于密度泛函理论的从头计算分子动 力学方法,对半导体材料硅、锑化铟、闪锌矿结构的碳 化硅等在强激光作用下的电子特性与晶格稳定性进行 了模拟研究^[69]。RECOULES 等人用强激光照射金属 和半导体物质,通过研究电子温度对声子谱的影响,讨 论了晶体物质的稳定性^[10]。ZIJLSTRA 等人采用基于 从头计算的方法,模拟研究了锑化铟晶体在强激光辐 照下的超快非热熔化^[11]。SHEN 等人^[12-13]基于密度 泛函理论,模拟研究了 Al₂Au,Cu 和 Ag 在强激光辐射 下的电子特性、晶格稳定性和热容量等物理特性的变 化。

激光诱导半导体超快速物理变化是不同于传统的 热过渡物理变化,它是一个非热性质的物理变化,电子

基金项目:国家科技支撑计划资助项目(2014GB111001; 2014GB125000);四川省教育厅自然科学基金重点资助项目 (16ZA0363)

作者简介:邓发明(1966-),男,副教授,现主要从事强激 光对凝聚态物理性质影响方面的研究。

和空穴的有效质量将发生变化,同时半导体的电子特性也将明显地发生变化。由于强激光照射使晶体非热熔化,晶体物质的物理特性的改变受到了材料科学与物理学的科学家们极大关注。碳化硅(SiC)是一种重要的结构材料和间接宽带隙的半导体晶体材料^[14],因其特殊的物理和化学特性而在电力电子领域和光电集成方面有着独特的应用,尤其是在短波发光材料使用方面,相比于Si,GaAs等传统的半导体材料,SiC晶体的物理与化学特性就更加优越^[15]。近年来,SiC晶体在微电子和光电子领域的应用研究也是热点,其研究成果越来越广泛地应用在紫外探测器、薄膜发光二极

管及光致发光材料和光电集成器件等方面^[16-17]。 关于纤锌矿结构材料之一的4H—SiC 晶体的报 道有4H—SiC TPJBS 二极管器件结构和器件仿真^[18]、 用微波光电导衰减法测量 N型4H—SiC 少数载流子 寿命研究其电学特性^[19]、通过对 P型4H—SiC 少数载 流子寿命的研究来分析其电学特性^[20]、常温常压下分 析4H—SiC 的能带结构^[21]等方面,而对于强激光照射 该晶体后其电子特性的变化研究较少。因此,研究在 强激光辐照下,4H—SiC 晶体电子特性的变化是有意 义的。使用密度泛函微扰理论(density functional perturbation theory, DFPT)和平面波赝势方法,通过计算 4H—SiC 在不同电子温度 *T*。下的能带结构、总的电子 态密度(density of states, DOS)和分波态密度(partial density of states, PDOS),分析了4H—SiC 晶体在强激 光照射下其电学特性的变化。

首先测试了 4H—SiC 晶体在不同电子温度下的 晶格平衡参量 $a \ n c$,然后利用 $a \ n c$ 在同一电子温度 T_e 下测试了晶体的电子特性,由此表明在该电子温度 T_e 下的强激光照射时晶体所呈现的电子特性;只有将 参量 $a \ n c \ = T_e$ 设置在同一电子温度下对应的值来 检测其电子特性才有意义。另外,在等离子体理论中, 电子温度 T_e 通常指的是等离子体中电子运动的动能, 常用电子伏特(eV)作为电子温度 T_e 的单位;在高温 度时,可以大概从电子温度 T_e 估计开尔文温度:因 1eV 所代表的能量 1.602 × 10⁻¹⁹ J,将电子温度转化为以焦耳 为能量单位后,除以玻尔兹曼常数 1.381 × 10⁻²³ J·K⁻¹, 便得到所对应的开尔文温度,由此可算得其换算因子是: 1eV 等效于热力学温度 1.16 × 10⁴ K。

在强激光辐照下,随电子温度 T_e 的增加,检测到 4H—SiC 晶体平衡晶格参量 a 和 c 也在增大。而对于 能带结构的变化,一方面,随 T_e 的增大,4H—SiC 晶体 的导带底从高对称点 M 处开始产生移动,但价带顶始 终在高对称点 Γ 点处不动,从而导致 4H—SiC 晶体在 强激光辐照下由间接带隙变成了直接带隙晶体;其中, 电子温度在 0eV ~2.75eV 范围内,导带底位于高对称 点的 M 点处,4H—SiC 是间接带隙晶体;当电子温度 继续升高达到 3.0eV 及以上时,导带底和价带顶同时 处于高对称点 Γ 点处而导致 4H—SiC 晶体转变成直 接带隙的半导体晶体了。

另一方面,检测到4H—SiC 晶体的导带底能量和 价带顶能量随电子温度 T. 升高相对于费米能级能量 朝低能量或高能量方向发生了明显的移动。其中,当 电子温度在 0eV~1.5eV 范围内时,随电子温度升高, 4H—SiC 晶体能带结构的价带顶能量朝费米能级能量 的低能量方向移动;当电子温度达到并超过约1.5eV 以后,随电子温度升高,价带顶能量朝费米能级的高能 量方向较快地移动并向上靠近费米能级;当电子温度 在 0eV ~ 1.5eV 范围内时,随电子温度的升高, 4H—SiC 晶体能带结构的导带底能量朝费米能级的低 能量方向移动;当电子温度在 1.5eV~2.5eV 范围内 时,随电子温度的升高,导带底的能量朝高能量方向移 动;当电子温度在 2.5eV~3.25eV 范围内时,随电子 温度的升高,导带底能量快速地降低;当电子温度 T。 升高到3.5eV时,导带底的能级能量低于0eV,费米能 级穿越了导带底。

再一方面,检测到 4H—SiC 晶体带隙值随电子温度 T_e 升高而发生了变化。其中,4H—SiC 晶体能带结构的带隙值在电子温度 0eV ~ 2eV 范围内是增大的;带隙值在电子温度超过 2.0eV 以后是快速减小的;当 T_e 升高到 3.5eV 及以后时,由于导带能量快速降低而穿过费米能级导致带隙消失了,晶体 4H—SiC 因导电能力增强而表现为金属特性。表明了 4H—SiC 固体在强度超过 3.5eV 的强激光的照射下,晶体的电子特性明显增强,晶体经历了一个熔化过程,过渡到金属状态。最后,对 4H—SiC 晶体的总电子态密度与分波态密度进行了计算分析。分析结果显示:电子温度 T_e = 0eV 时,4H—SiC 晶体带隙值为 2.2eV;电子温度 T_e = 6.0eV 时,因带隙消失而表现出金属的特性。

在利用4H—SiC 晶体制作特殊功能电子元件时, 上述检测到的4H—SiC 晶体在强激光辐照下所呈现 的电子特性,可以为它们提供第一性原理基础数据。

1 计算描述

本文中使用基于密度泛函微扰理论的第一性原理 赝势法,模拟研究了4H—SiC 晶体在强激光照射下的 电学特性的变化。在模拟研究中选用广义梯度近似 (generalized gradient approximation, GGA)作为赝 势^[22],采用 ABINIT 程序包^[23-24]进行计算。为了得到 4H—SiC 晶体在强激光作用下的第一性原理基础数

241

技

术

据,检测分3步进行。第1步是收敛性测试,选取模守 恒 GGA 赝势对 4H—SiC 晶体的平面波截止能量和 k 点网格进行收敛测试,检测结果表明,当截止能量取 27.2114eV 和 k 点网格取 2 × 2 × 1 时,系统的总能量 可以很好地收敛;第2步是对4H—SiC晶体平衡晶格 常数进行优化测试;第3步是利用优化后得到的截止 能量和平衡晶格参量,运用密度泛函微扰理论的线性 响应方法对 4H—SiC 晶体的电子态密度和能带结构 进行了测试,并选取了沿布里渊区的 Γ-A-H-K-Γ-M-L-H高对称点方向进行能带结构的检测。

用 ABINIT 程序包中的变量 tphysel 来设置电子温 度 T。的大小, T。的大小反映了激光强度的大小, 同时 也模拟反映了4H—SiC 晶体在强激光作用下使晶体 在超快时间内达到的电子温度。

2 结果与讨论

2.1 平衡晶格参量的优化

4H—SiC 晶体具有纤锌矿晶体结构特征、空间群 属于 P63mc, 群号是 186。其中, C 原子的价电子态为 2s²2p²,Si 原子的价电子态为 3s²3p²。测试 4H—SiC 晶体的基态结构参量,交换相关的相互作用采用 GGA,利用晶胞体积和总能量的最小化得到了晶体平 衡晶格参量。平衡晶格参量 a 和 c 是由晶胞的体积决 定,因为4H—SiC 晶体的对称性很高,故原子的位置 就不必再优化。测试得到的平衡晶格参量 a 的值是 0.31112nm, c 的值是 1.00500nm, 与 a 的实验值^[24] 0.30817nm 和c 的实验值1.00791nm 非常接近,其中 a 值与实验数据比较高估了 0.96%, c 值比实验值低估 了 0.42%: 也与用范数不变赝势法理论计算值^[21] a 值 0.3051nm 和 c 值 0.9984nm 十分接近,这在很大程度 上足以保证对电子特性做进一步研究的正确性。

2.2 晶格参量 a 和 c 随电子温度 T_{a} 的变化

在高强度的激光辐照下,4H—SiC 晶体内的电子 将在超快时间内被加热到很高的温度。检测了电子温 度 T。从 0eV ~ 5.0eV 范围内的 21 组晶格参量 a 和 c 的数据,如图1所示。从图1可以看出,在 $T_e = 0$ eV 时,平衡晶格参量 a = 0.31112nm, c = 1.00500nm; 电子 温度 T。在 0eV~1.5eV 范围内时, a 值稍微增大; 电子 温度 T_e 超过 1.5eV 后,a 值增大较为明显;电子温度 T。在 0eV ~0.75eV 范围内时, c 值稍微增大; 电子温度 T。在0.75eV~2.25eV范围内增大时,c值明显增大; 电子温度 T。增大超过 2.25 eV 后, c 值增大较为明显。 在强激光辐照时,4H—SiC 晶体在超快时间内吸收了 能量,引起更多的电子因能量增加而被激发到导带中, 原子间的吸引力被削弱,造成原胞内的碳原子和硅原



Fig. 1 Relationship between equilibrium lattice parameter a and c of crystal 4H—SiC and electron temperatures T_e

子在各自平衡位置处的非简谐热振动加强,增大了原 子与原子间的相互排斥力,打破了原有的晶格的力学 平衡,同时晶格参量快速地自我修复到一个新的值,从 而使晶胞重新处于新的晶格力学平衡状态;随电子温 度T。的增大,平衡晶格参量 a 和 c 也明显增大。在强 激光辐照下,检测到的4H-SiC 晶体平衡晶格常数发 生变化的情形与金刚石结构的碳^[25]以及硅晶体^[26-27] 研究的结果非常类似。

2.3 电子特性

2.3.1 能带结构随电子温度 T。改变而变化 随电子 温度的升高,晶体的电子特性的变化可由其能带结构 的变化来反映。分别选择了电子温度分别为 0eV 与 1.5eV,2eV 与 3eV 的两组能带结构进行对比分析,以 便说明4H—SiC 晶体在强激光照射下随电子温度 T。 的增大其能带结构发生的变化,并由此反映晶体电子 特性的变化。

如图 2 所示,其中 T_e = 0eV 的能带结构用实线表 示,T_e=1.5eV的能带结构用虚线表示,费米能级能量 设置为0eV。由图2表明,4H—SiC晶体第一导带底 位于布里渊区中的 M 点处,是二重简并的;价带顶位 于 Γ 点,是三重简并的;4H—SiC 晶体的能带结构具 有典型的纤锌矿材料能带结构的一般特征。 $T_e = 0 \text{ eV}$ 时的间接带隙值为 2.1972eV, 与实验值^[28] 3.47eV 相 比较减少了 37.2%。在运用局域密度泛函理论时,因 为没有考虑体系激发态条件而求解 Kohn-Shan 方程, 低估了激发态电子间的关联作用,从而使得理论计算 结果通常要小于实验值约30%~50%;但在同一体系 中,分析晶体在不同电子温度下电子特性的变化其结 果仍然是有意义的。 $T_e = 1.5 \text{eV}$ 时的间接带隙值为 2.2967eV,比T。=0eV时带隙值增大了;同时也检测 到能带结构发生了变化,一方面,T_e=1.5eV的能带结 构的高能量区相对于 $T_a = 0 \text{ eV}$ 的高能量区发生了整体 明显的下移, 而低能量区中能量在 0eV ~ -8eV范围内的能带相对于 $T_{a} = 0eV$ 低能区对应的部 分发生了下移,低能量区中能量在-8eV~-17.5eV



Fig. 2 Energy bands of 4H—SiC at two different electron temperatures: $T_e = 1.5 \,\text{eV}$ (dashed lines) and $T_e = 0 \,\text{eV}$ (solid lines)

范围内的能带则相对于 T_e = 0eV 低能区对应的部分几 乎上移了;另一方面,价带顶能量值在 T_e = 1.5eV 时是 -1.5303eV,与在 T_e = 0eV 时的值 -1.2178eV 相比, 朝能量低方向发生了能量为0.3125eV 的偏移量,而 T_e = 1.5eV 的导带底能量值0.7665eV 与 T_e = 0eV的导 带底能量值 0.9795eV 相比,朝低能量方向发生了能 量为0.2130eV 的偏移量,两个偏移量相差 0.0995eV, 表明 4H—SiC 晶体在 T_e = 1.5eV 的间接带隙值相比 于 T_e = 0eV 的间接带隙值增大了。

图 3 中,实线是 4H—SiC 晶体在 T_{a} = 2eV 时的能 带结构图,虚线是 T_e =3eV时的能带结构图。 T_e =3eV 时的能带隙值为1.0404eV,相比于T_e=2eV时的能带 隙值 2.3268eV 明显减少了。能带结构的变化表现 在:一方面导带底能量和位置的变化,T。=2eV的导带 底位于高对称点 M 点,其能量值为 0.9554eV 点处,晶 体仍是间接带隙的半导体;T_e=3eV的导带底位置移 动到位于高对称点 Γ 点,其能量值为 0.2831 eV 点处, 表明电子温度升高后其导带底位置移动了且能量也降 低了,因价带顶与导带底同时位于高对称点 Γ 点导致 晶体变为直接带隙的半导体;另一方面,T。=3eV的价 带相对于 T_e=2eV 的价带整体向高能量方向发生了移 动,而 T_e = 3eV 的导带相对于 T_e = 2eV 的导带整体向低 能量方向发生了移动;其中,T。=3eV的价带顶能量值 -0.7573eV 与 T_e = 2eV 的价带顶能量值 -1.3714eV 相 比,朝高能量方向发生了能量为0.6141eV的偏移量, 而 T_e = 3eV 的导带底能量值 0. 2831eV 与 T_e=2eV的导带底能量值0.9554eV相比,朝低能量方



Fig. 3 Energy bands of 4H—SiC at two different electron temperatures: $T_e = 3 \,\mathrm{eV}(\text{ dashed lines})$ and $T_e = 2 \,\mathrm{eV}(\text{ solid lines})$

向发生了能量为 0. 6723 eV 的偏移量,由此导致 T_e = 3eV 时相比于 T_e = 2eV 时的导带底与价顶之间能量间 隔总的偏移量为1. 2864 eV,表明 4H—SiC 晶体在 T_e = 3eV 的间接带隙值 1. 0404 eV 相比于 T_e = 2eV 的间接带隙值 2. 3268 eV 减小了 1. 2864 eV。

2.3.2 导带底与价带顶位置随电子温度 T_e 的变化 在强激光辐照下,电子温度 T_e 在 0eV ~ 3.5eV 范围时 选择了 14 个电子温度,并检测出了这 14 个电子温度 对应的 14 组能带结构数据,分析这 14 组能带结构数 据,并由此得到了 4H—SiC 晶体随电子温度的升高其 导带底和价带顶位置发生的变化关系。

检测到随着电子温度在 0eV ~3.5eV 范围内的升高,4H—SiC 晶体的价带顶仍位于高对称点的 Γ 点处,价带顶的位置不变化,但导带底的位置随电子温度的升高却发生了变化。其中,电子温度在 0eV ~ 2.75eV 范围内变化,导带底位置在布里渊区的高对称 点 M 处;当电子温度再升高达到 3.0eV 及以上时,导带底又回到高对称点 Γ 点处。由此表明,电子温度在 0eV ~2.75eV 范围时,4H—SiC 是间接带隙的半导体 晶体,当电子温度达到 3.0eV 及以上后,因导带底和 价带顶同时位于高对称点 Γ 点处,从而使 4H—SiC 变 为直接带隙的晶体了。

2.3.3 价带顶能量与导带底能量随电子温度 T_e 的变化 在图 2 和图 3 中,能带结构随不同的电子温度 T_e 而发生了相对移动,随电子温度的升高,能带结构相对移动的方向也并不一致,但价带顶和导带底的移动方向可以近似地反映能带结构随电子温度升高而发生的变化。为了更清楚地反映这种变化,计算了价带顶和导带底在电子温度 T_e 为 0eV ~ 3.5eV 范围内的 14 组能量值并作图,如图 4 所示。图 4 中粗实线表示的是导带底能量随电子温度 T_e 的变化, 费米能级设为 0eV。由图 4 可以看出:首先,当电子温度在 0eV ~ 1.5eV 范围内时,随电子温度升高,晶体价带顶能量相对费米能量朝低能量方向移动;当电子温度达到并超过 1.5eV



Fig. 4 The bottom of conduction band and the top of value band of 4H— SiC with the change of T_a

技

光

激

术

后,晶体价带顶能量相对于费米能量随电子温度升高 朝高能量方向迅速地上移并接近费米能级;其次,当电 子温度 T_e 在 0eV ~1.5eV 范围内时,随电子温度升 高,导带底的能量向低能量方向移动;当电子温度在 1.5eV ~2.5eV 范围内时,随电子温度升高,导带底的 能量向高能量方向移动;当电子温度在 2.5eV ~ 3.25eV 范围内时,随电子温度升高,导带底的能量快 速地降低;当电子温度 T_e 升高到 3.5eV 时,导带底的 能级能量低于 0eV,费米能级穿越了导带底。

上述分析表明,当电子温度升高到达到 3.5eV 后,一是导带底的能级能量快速地降低到低于费米能 级,二是价带顶的能级能量也较快地接近费米能级,从 而使得价带内的电子更容易地激发到较低能量的导带 中,导致导带内因有电子的出现使得晶体的导电性能 增强而表现为金属特性。表明了 4H—SiC 晶体在强 激光的照射下,晶体的电子特性增强,晶体经历了一个 熔化过程,过渡到金属状态,这与 WANG 等人^[8]利用 密度泛函从头计算的方法对闪锌矿结构的锑化铟半导 体晶体的理论计算结果相似。

2.3.4 能带结构的禁带宽度随电子温度 T_e 的变化 在图 4 中,检测到在同一电子温度 T_e 下,价带顶和导 带底能量相对移动量并不是相同的,二者之间的带隙 值随电子温度 T_e 在 0eV ~ 3.25eV 范围内升高时发生 变化。为了能清晰地反映随电子温度升高带隙值发生 的变化,选取了不同电子温度对应的 13 组带隙值作 图,如图 5 所示。从图 5 中可以看出:带隙值随电子温 度 T_e 在 0eV ~ 2eV 范围内增大而加大,当电子温度超 过 2.0eV 以后,带隙值随电子温度升高而快速减少; 并且还测试到当电子温度 T_e = 3.5eV 时,4H—SiC 晶 体由于导电能力增加而呈现出金属特性,带隙失去了 意义,故在作图处理中不考虑电子温度超过 3.25eV 的部分。





2.3.5 电子态密度随电子温度 *T*_e 的变化 用强度达 到电子温度为 3.5 eV 的强激光照射 4H—SiC 晶体后, 系统经历了一个熔化过程,过渡到金属状态,这种过渡 表明,随电子温度 *T*_e 的增加,其总的电子态密度在发

生变化,如图 6 所示。分别给出了 0eV 和 6.0eV 两种 电子温度下总的电子态密度图,费米能级设为 0eV。 在 $T_e = 0eV$ 时,电子态密度图显示 4H—SiC 晶体带隙 值为 2.2eV;在 $T_e = 6.0eV$ 时,电子态密度图显示 4H—SiC 晶体的费米能因缺少空带呈现出金属特性。 这里,还分别计算 4H—SiC 晶体在 $T_e = 0eV$ 和 $T_e = 6.0eV$ 时的分波电子态密度,用以分析 4H—SiC 晶体 在强激光辐照下电子态密度的变化。



Fig. 6 Electron densities of states of 4H—SiC crystal at electronic temperatures $T_e = 0 \text{eV}$ and $T_e = 6.0 \text{eV}$

图7 中显示了晶体4H—SiC 在 T_e = 0eV 时总的电 子态密度和分波电子态密度分布情况。由图7 可以看 出,最高价带在 – 5eV ~ – 1eV,主要来自于 Si 的 3p 态 和 C 的 2p 态的贡献,C 的 2s 态,C、Si 的 3d 态也有少 许贡献。最低导带主要由 C 的 2s 态、Si 的 3d 态的贡 献,C 的 2p、Si 的 3s 态贡献很小。4H—SiC 晶体的电 子总态密度显示带隙在 T_e = 0eV 时约为 2.2eV。



Fig. 7 Partial and total densities of states of 4H—SiC at $T_e = 0 \text{ eV}$

图 8 中显示了 4H—SiC 晶体在 $T_e = 6.0 \text{eV}$ 时的总 电子态密度和分波电子态密度分布情况。由图 8 可以 看出,介于 - 5 eV ~ - 3.5 eV 最低价带能量的贡献来源 于 Si 的 3p 态和 C 的 2p 态,靠近费米能级的价带能量 主要来自于 Si 的 3p 态和 C 的 2p 态的贡献。在 $T_e =$



Fig. 8 Partial and total densities of states of 4H—SiC at $T_e = 6.0 \text{eV}$ 6.0eV 时,电子态密度显示 4H—SiC 晶体带隙消失了, 呈现出金属特性。表明当电子温度 T_e 升高到了一定 强度时,4H—SiC 晶体因非热熔化过渡到金属状态。 计算的结果也与强激光对 InSb^[8,29],Si^[6-7],GaAs^[30]超 快作用研究的结果类似。

3 强激光作用后4种典型碳化硅晶体电学特性的对比

为了便于反映 4H—SiC 晶体在强激光照射下所 表现的电子特性变化,将先前对多体型碳化硅晶体中 的 3C—SiC 晶体、2H—SiC 晶体和 6H—SiC 晶体在强 激光作用下的研究结果^[31-33]与 4H—SiC 晶体的研究 结果进行对比分析。下面主要从平衡晶格参量、价带 顶与导带底参量变化、带隙值随电子温度的变化、电子 温度为 0eV 时的带隙值大小、晶体结构类型的变化、 呈现金属特性时的临界电子温度值等几个方面进行对 比。

(1) 在强激光作用下, 3C—SiC 晶体, 随电子温度 *T_e* 升高, 平衡晶格参量 *a* 在逐渐增大; 2H—SiC 晶体、 4H—SiC 晶体和 6H—SiC 晶体随 *T_e* 升高, 平衡晶格参 量 *a* 和 *c* 分别也在逐渐增大。

(2) 在强激光作用下,4 种晶体能带结构的价带顶 与导带底能量随电子温度的升高在发生变化。3C— SiC 晶体,随 *T*。的升高,价带顶与导带底的能量先向 低能量方向移动,后又向高能量方向移动;2H—SiC 晶体随 *T*。的升高,价带顶与导带底的能量先向低能量 方向移动,后又向高能量方向移动,最后导带底能量朝 低能量方向移动,而价带顶能量快速地升高并穿越费 米能级能量;4H—SiC 晶体随 *T*。的升高,价带顶与导 带底的能量先向低能量方向移动,后又向高能量方向 移动,最后导带底能量向低能量方面移动并穿越费米能级能量;6H—SiC晶体随*T*。的升高,价带顶与导带底的能量先向低能量方向移动,后二者又快速地向高能量方向移动,最后价带顶快速地穿越费米能级能量。

(3)4种晶体的带隙值随电子温度的升高在发生 变化。3C—SiC 晶体随 *T*。的升高其带隙值在逐渐增 大,*T*。超过 5.1eV 后带隙消失;2H—SiC 晶体随 *T*。的 升高其带隙值先是在逐渐增大,后又快速地降低,当 *T*。超过 3.5eV 后,带隙消失;4H—SiC 晶体带隙值随 电子温度升高发生变化的形情同 2H—SiC 晶体一样; 6H—SiC 晶体随 *T*。的升高,其带隙值先是在逐渐增 大,后又快速地降低,当*T*。超过 4.25eV 后,带隙消失。

(4) 在电子温度为 0eV 时, 3C—SiC 晶体带隙值是 1.31eV, 2H—SiC 晶体带隙值是 2.298eV, 4H—SiC 晶 体带隙值是 2.1972eV, 6H—SiC 晶体带隙值是 2.0616eV。

(5)随电子温度的升高,4种晶体结构类型有发生改变。3C—SiC 晶体 T_e 在 0eV ~ 5.0eV 范围内升高时,仍是间接带隙的半导体晶体;2H—SiC 晶体当 T_e 在 0eV ~ 2.25eV 范围内升高时是间接带隙的半导体晶体,当 T_e 达到并超过 2.5eV 后转变为直接带隙的半导体晶体;4H—SiC 晶体当 T_e 在 0eV ~ 2.75eV 范围内升高时是间接带隙的半导体晶体,当 T_e 达到并超过 3.0eV 后转变为直接带隙的半导体晶体,当 T_e 达到并超过 3.0eV 后转变为直接带隙的半导体晶体;6H—SiC 晶体当 T_e 在 0eV ~ 3.87eV 范围内升高时是间接带隙的半导体晶体,当 T_e 达到并超过 3.89eV 后转变为直接

(6)3C—SiC 晶体当 $T_e > 5.1 \text{eV}$ 后,价带顶穿越费 米能级,带隙消失而呈金属特性;2H—SiC 晶体当 $T_e > 3.5 \text{eV}$ 后,价带顶穿越费米能级,带隙消失而呈金属特 性;4H—SiC 晶体当 $T_e > 3.5 \text{eV}$ 后,导带底穿越费米能 级,带隙消失而呈金属特性;6H—SiC 晶体当 $T_e > 4.25 \text{eV}$ 后,价带顶穿越费米能级,带隙消失而呈金属 特性。

4 结 论

在强激光辐照作用下,检测到4H—SiC 晶体的平 衡晶格参量 a 和 c 被检测到随电子温度 T_e 的升高在 逐渐增加。检测到4H—SiC 晶体能带结构中导带底 的位置由高对称点 M 点随电子温度的升高发生了移 动,价带顶位置位于高对称点 Γ 点处但不随电子温度 的升高而发生移动;当电子温度继续升高达到 3.0eV 及以上时,导带底又回到高对称点 Γ 点处,4H—SiC 晶体则由间接带隙晶体变成了直接带隙晶体。检测到 4H—SiC 晶体的导带底和价带顶能量相比于费米能级 激光技术

能量随着电子温度的升高朝低能量或高能量方向发生 了移动,4H—SiC 晶体的带隙值也发生了相应的变化; 4H—SiC 晶体在电子温度超过3.5eV 的强激光的照射 下,晶体的电子特性增强,晶体经历了一个熔化过渡到 金属状态。

参考文献

- van VECHTEN J A, TSU R, SARIS F W. Nonthermal pulsed laser annealing of Si plasma annealing [J]. Physics Letters, 1979, A74 (6):422-426.
- [2] SHANK C V, YEN R, HIRLIMANN C. Time-resolved reflectivity measurements of femtosecond optical pulse induced phase transitions in silicon[J]. Physical Review Letters, 1983, 50(2): 454-457.
- [3] SAETA P, WANG J, SIEGAL Y, et al. Ultrafast electronic disordering during femtosecond laser melting of GaAs[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(8):1023-1026.
- [4] LARSSON J, HEIMANN P A, LINDENBERG A M, et al. Ultrafast structural changes measured by time-resolved X-ray diffraction [J]. Applied Physics, 1998, A66(6):587-591.
- [5] UTEZA O P, GAMALY E G, RODE A V, et al. Gallium transformation under femtosecond laser excitation: phase coexistence and incomplete melting[J]. Physical Review, 2004, B70(5):054108.
- [6] SILVESTRELLI P L, ALAVI A, PARRINELLO M, et al. Structural, dynamical, electronic, and bonding properties of laser-heated silicon: an ab initio molecular-dynamics study [J]. Physical Review, 1997, B56(8): 3806-3812.
- [7] SILVESTRELLI P L, ALAVI A, PARRINELLO M, et al. Ab initio molecular dynamics simulation of laser melting of silicon[J]. Physical Review Letters, 1996, 77(15): 3149-3152.
- [8] WANG M M, GAO T, YU Y, et al. Effect of intense laser irradiation on the lattice stability of InSb[J]. The European Physical Journal Applied Physics, 2012, 57(1):10104.
- [9] DENG F M, GAO T, SHEN Y H, et al. Effect of intense laser irradiation on the structural stability of 3C-SiC[J]. Acta Physica Sinica, 2015, 64(4):046301 (in Chinese).
- [10] RECOULES V, CLÉROUIN J, ZÉRAH G, et al. Effect of intense laser irradiation on the lattice stability of semiconductors and metals
 [J]. Physical Review Letters, 2006, 96(5):055503.
- [11] ZIJLSTRA E S, WALKENHORST J, GILFERT C, et al. Ab initio description of the first stages of laser-induced ultra-fast nonthermal melting of InSb[J]. Applied Physics, 2008, B93(4):743-747.
- [12] SHEN Y H, GAO T, WANG M M. Effect of intense laser irradiation on the lattice stability of Cu and Ag[J]. Computational Materials Science, 2013, 77(3):372-376.
- [13] SHEN Y H, GAO T, WANG M M. Effect of intense laser irradiation on the lattice stability of Al₂Au[J]. Communication in Theoretical Physics, 2013, 59(5): 589-593.
- [14] MATSUNAMI H. Current SiC technology for power electronic devices beyond Si[J]. Microelectronic Engineering, 2006, 83(1):2-4.
- [15] WEITSEL C E. Silicon carbicle high frequency devices [J]. Materials Science Forum, 1998, 264/268;907-912.
- [16] COSTA A K, CAMARGO J R S S. Amorphous SiC coatings for WC cutting tools[J]. Surface and Coatings Technology, 2003, 163/164 (2):176-180.

- [17] ROTTNER K, FRISCHHOLZ M, MYRTVEIT T, et al. SiC power devices for high voltage applications[J]. Materials Science & Engineering, 1999, 61/62(98):330-338.
- [18] ZHANG H P, QI R S, WANG D J, et al. Device structure and simulations of 4H—SiC TPJBS diode [J]. Power Electronics, 2011, 45 (9):35-38 (in Chinese).
- [19] GAO D M, LU Q R, WEI Y B, et al. Minority carrier lifetime measurement for N-type 4H—SiC by means of the microwave photoconductivity decay method[J]. Laser Technology, 2011, 35(5): 610-612 (in Chinese).
- [20] GAO D M, LU Q R, WEI Y B, et al. Study on minority carrier litetime of P type 4H—SiC[J]. China Measurement & Test, 2012, 38 (1): 19-21 (in Chinese).
- [21] JIANG Z Y, XU X H, WU H S, et al. Studies on the geometric and electronic structure of SiC polytypes [J]. Acta Physica Sinica, 2002, 51(7):1586-1590 (in Chinese).
- [22] TROULLIER N, MARTINS J L. A straightforward method for generating soft transferable pseudopotentials [J]. Solid State Communications, 1990, 74(7):613-616.
- [23] GONZE X, BEUKEN J M, CARACAS R, et al. First-principles computation of material properties: the ABINIT software project[J]. Computational Materials Science, 2002,25(3):478-492.
- [24] CAMP P E, DOREN V, DEVREESE J T. First principles calculation of the pressure coefficient of the indirect band gap and of the charge density of C and Si[J]. Physical Review, 1986, B34(9): 1314-1316.
- [25] FENG S Q, ZHAO J L, CHENG X L. A first principles study of the lattice stability of diamond-structure semiconductors under intense laser irradiation[J]. Applied Physics, 2013, J113(2):023301.
- [26] THOMPSON M O, GALVIN G J, MAYER J W, et al. Melting temperature and explosive crystallization of amorphous silicon during pulsed laser irradiation [J]. Physical Review Letters, 1984, 52 (26):2360-2363.
- [27] POATE J M, BROWN W L. Laser annealing of silicon[J]. Physics Today, 1982, 35(6):24-30.
- [28] LIU Z L. Advantage and development foreground of SiC power semiconductor devices [J]. Power Electronics, 2009(6):10-13(in Chinese).
- [29] GROMOV G G, KAPAEV V V, KOPAEV Y V. Semiconductormetal phase transition induced in InSb by a strong electromagnetic field[J]. Zhurnal Eksperimental' noii Teoreticheskoi Fiziki, 1988, 94(12):101-113.
- [30] SOKOLOWSKI-TINTEN K, BIALKOWSKI J, VON DER LINDE D.
 Ultrafast laser-induced order-disorder transitions in semiconductors
 [J]. Physical Review, 1995, B51(20):14186.
- [31] DENG F M, GAO T. Effect of intense laser irradiation on the electronic properties of 3C-SiC[J]. Chemical Research and Application, 2016, 28(5):681-687 (in Chinese).
- [32] DENG F M. Effect of intense laser irradiation on the electronic properties of 2H-SiC[J]. Acta Physica Sinica, 2015, 64(22): 227101 (in Chinese).
- [33] DENG F M. Effect of intense laser irradiation on the electronic properties of 6H-SiC[J]. Acta Physica Sinica, 2016, 65(10): 107101 (in Chinese).